

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2019-80

天津中环半导体股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中环股份	股票代码	002129
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦世龙	蒋缘	
办公地址	天津新技术产业园区华苑产业 区(环外)海泰东路 12 号	天津新技术产业园区华苑产业 区(环外)海泰东路 12 号	
电话	022-23789787	022-23789787	
电子信箱	qinshilong@tjsemi.com	jiangyuan@tjsemi.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,941,541,884.91	6,461,245,301.29	22.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	452,145,092.40	300,045,198.83	50.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	354,024,686.87	223,261,831.51	58.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	852,155,908.39	540,450,893.17	57.67%
基本每股收益(元/股)	0.1623	0.1135	43.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1623	0.1135	43.00%
加权平均净资产收益率	2.61%	2.51%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	45,060,031,522.82	42,697,311,470.60	5.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,695,945,546.33	13,324,854,829.15	2.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	27.55%	767,225,207	17,912,482		
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	国有法人	9.64%	268,510,983	0		
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	3.02%	83,983,137	83,983,137		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.22%	61,804,100	0		
汇安基金－兴业银行－汇安基金－北方工业资产管理计划	国有法人	1.03%	28,694,404	28,694,404		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	20,024,901	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.68%	19,009,300	0		

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	境内非国有法人	0.60%	16,731,011	0	
天津药业集团有限公司	国有法人	0.49%	13,785,977	0	
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.49%	13,755,784	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。				

注：天津中环电子信息集团有限公司持股数量 767,225,207 股，其中包括 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 20 日中环集团通过证券公司定向资管计划采取集中竞价方式增持股份 22,100,033 股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简	债券代码	到期日	债券余额	利率
------	-----	------	-----	------	----

	称			(万元)	
天津中环半导体股份有限公司 2015 年公司债券	15 中环债	112265	2020 年 08 月 13 日	6,293.68	6.10%
天津中环半导体股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 中环 01	114097	2019 年 01 月 12 日	0	5.30%
天津中环半导体股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	19 中环 01	112860	2025 年 03 月 05 日	45,000	6.00%
天津中环半导体股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）	19 中环 02	112824	2025 年 08 月 09 日	60,000	5.75%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	61.63%	63.17%	-1.54%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.01	3.34	50.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019 年上半年，从整体国际形势来看，中美贸易摩擦的升级，未来世界经济不稳定、不确定因素越来越多，整体回升基础仍然薄弱。从国内角度来看，推动高质量发展、调整产能过剩和产业结构升级、新旧发展动能转换的问题依然是经济工作的重点，同时由于生产要素配置率不高、创新能力不足，资金面整体趋紧，资本回报率和潜在经济增长趋缓。公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕公司“十三五”战略规划目标，加速推动各项工作的整体要求，在半导体材料及器件、新能源材料、光伏电站等产业，面对全国性的结构调整和产业转型，重整组织、再造流程、全面创新，坚持公司跨地域、跨领域、多业态、规模化、国际化、多元化发展，整合组织、兼容文化，持续创新，深化各业务板块运营能力、综合竞争力，推动公司高质量发展。

报告期内，实现营业总收入 794,154.19 万元，较上年同期增长 22.91%，经营性现金流量净额 85,215.59 万元，较上年同期增长 57.67%，含汇票的经营性现金流净额 198,125.83

万元，较上年同期增长 113.80%，归属于上市公司股东的净利润 45,214.51 万元，较上年同期增长 50.69%；报告期末总资产为 4,506,003.15 万元，较期初增长 5.53%；归属于上市公司股东的净资产为 1,369,594.55 万元，较期初增长 2.78%。

半导体产业领域：

2019 年半导体行业进入调整期，由中美贸易战、日韩贸易战带来半导体产业对市场发展的不确定性，以及下一代通讯技术 5G 带来的技术不确定性，半导体行业迎来短期波动下行。2019 年公司重点布局国际大客户开发，一方面平衡市场波动带来的供应量、价格风险，一方面通过与国际客户配合，提升对面国际一流客户的技术、质量控制能力。2019 年上半年公司产品在国际一流客户销售占比同比提升 2 倍以上，为后续公司业务的持续增长打下良好基础。通过供应国际一流客户，公司产品国际知名度及认可度进一步提升。

在半导体材料方面，结合市场需求，公司重点推进半导体材料产品结构的战略性升级。以中环领先为核心，积极通过集约创新、集成创新、联合创新、协同创新等形式，联合当地政府及上市公司，组织实施横跨天津、内蒙、江苏的“集成电路用半导体大硅片”项目。其中 2019 年上半年，天津工厂 8 英寸硅片扩产项目已实现设计产能；12 寸试验线项目于 2 月产出，并持续进行研发工作；宜兴工厂预计下半年 1 条 8 英寸产线投产，12 英寸项目预计 2019 年第四季度实现设备搬入，2020 年第一季度开始投产，按项目设计进度持续推进。

在半导体器件方面，功率半导体芯片（SBD、VDMOS）依靠稳定的产业平台，积极开发的 TMBS、TrenchMOS 等产品，丰富产品结构，实现产业平台升级。公司自主研发设计印刷法 GPP 玻璃钝化芯片新工艺已实现量产，以创新工艺为核心实现产品转型升级。功率器件依靠原有的 SBD/VDMOS 产业平台，积极开发 TMBS、TrenchMOS 等产品，搭建更合理的产品结构，通过与中科院微电子进行产业、技术合作，打造创新产业化新项目，积极向高端半导体器件领域拓展。同时合资合作打造分立器件封装基地，以更节能环保、综合成本更低的优势推动半导体分立器件制造和封装制造的完善，进一步扩大半导体器件产品的销售与生产规模。

新能源光伏材料产业领域：

全球光伏行业即将进入平价上网时代，落后产能将被淘汰，全球新能源材料优质产能供给紧缺，资源进一步向拥有先进产能的企业集中。公司重点在内蒙古地区扩张光伏材料产能，四期及四期改造项目已全部达产，通过设立黄金工位、推行标准化作业、联合作业、优化工艺等工作，2019 年上半年太阳能级单晶硅材料年产能合计达到 30GW，月产破万吨。中环协鑫五期项目已顺利开工建设，通过项目的智慧化工厂设计及制造、组织、管理模式优化，坚持

以半导体产品思维制造光伏产品，以支撑光伏产业持续性升级，更好地满足光伏市场未来对新能源材料品质高效化、多样化的需求，持续保持全球新能源材料领域领先地位。在技术创新方面，通过不断研发，公司新产品已实现重大技术突破，涉及百余项已申报专利及自有知识产权技术，实现新产品跨代，为全产业链客户贡献价值，进一步提升光伏行业的竞争能力，推动全球光伏产业平价上网。在江苏实施的 10GW 钻石线切割超薄硅片项目，通过工艺技术进步与精益制造，在作业人员减少的同时增加市场供给，提高全员劳动效率、打造现代化智能工厂；在天津实施钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目，通过智能管理系统、智能物流、智能仓储运及自动生产设备有机结合，打造光伏材料制造智慧化工厂。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、新设子公司情况：当雄友豪新能源发展有限公司。

2、清算子公司情况：唐山环兴新能源有限公司、包头市环兴光电有限公司、呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司。

天津中环半导体股份有限公司

董事长：沈浩平

2019 年 8 月 21 日